附件一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自动化学院赴日参加“樱花科技计划”学术交流申请表** | | | | | | | | |
| **姓名** |  | **班号** | |  | **政治面貌** | | |  |
| **平均学分绩点** |  | **专业排名** | |  | **英语水平** | | |  |
| **是否科研立项** |  | **科研立项题目** | | |  | | | |
| **申请人联系电话** |  | | | **申请人邮箱** | | |  | |
| **院内导师** |  | | **是否有意向在本院读研** | | |  | | |
| **申请人理由**  （学科及科技竞赛获奖、科研成果等，可附页） | | | | | | | | |
| 本人签字：  年 月 日 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **导师意见** | | | | **学院审批意见** | | | | |
| 签字（签章）：  年 月 日 | | | | 签字（签章）：  年 月 日 | | | | |